**MEDIENINFORMATION**

ASMPT gewinnt zum zweiten Mal   
in Folge den exklusiven Texas Instruments Supplier Excellence Award

München, 12. August 2024 – ASMPT Limited, der weltweit führende Anbieter von integrierten Lösungen für die Halbleiter- und Elektronikfertigung, wurde kürzlich zum zweiten Mal in Folge von Texas Instruments (TI) mit dem 2023 Supplier Excellence Award ausgezeichnet. Diese prestigeträchtige Auszeichnung unterstreicht das Engagement von ASMPT, Produkte und Dienstleistungen zu bieten, die den hohen Standards von TI entsprechen.

Das umfangreiche globale Lieferantennetzwerk von Texas Instruments (TI) umfasst über 10.000 Unternehmen. ASMPT gehört dabei zu einer ausgewählten Gruppe von Premium-Anbietern, die aufgrund ihrer herausragenden Leistungen in den Bereichen Kostenmanagement, Umwelt- und Sozialverantwortung, Technologie, Reaktionsfähigkeit, Liefersicherheit und Qualität besonders ausgezeichnet wurden.

"ASMPT fühlt sich geehrt, diese sehr angesehene Auszeichnung von Texas Instruments zum zweiten Mal in Folge zu erhalten", sagte Joseph Poh Tson Cheong, Co-CEO  
Semiconductor Solutions von ASMPT. "Die Anforderungen für diese Auszeichnung sind sehr hoch, und sie zwei Jahre lang zu erhalten, ist eine wunderbare Auszeichnung, die unser Engagement für nachhaltigen Kundenerfolg und starke Partnerschaften unterstreicht."

"Als ein wichtiger Lieferant von TI sind wir setzen wir uns aktiv dafür ein, durchgängig umfassenden Support für das Equipment zu gewährleisten – unabhängig von den Herausforderungen in der Lieferkette. Damit unterstützen wir TI dabei, seine Roadmap voranzutreiben und seine Ziele zu erreichen."

**Verfügbares Bildmaterial**

Folgendes Bildmaterial steht druckfähig im Internet zum Download bereit:   
<https://kk.htcm.de/press-releases/asmpt/>

|  |
| --- |
|  |
| **2023 Texas Instruments Supplier Excellence Award**  Bildquelle: ASMPT |

**Über ASMPT Limited („ASMPT“)**

ASMPT mit Hauptsitz in Singapur ist weltweit führender Anbieter von Hard- und Softwarelösungen für die Semiconductor- und Elektronikfertigung. Das Angebot von ASMPT umfasst die Bereiche Semiconductor Assembly und Packaging sowie SMT (Surface Mount Technology): von der Wafer-Beschichtung bis hin zu den verschiedensten Lösungen für Assembly und Packaging empfindlicher elektronischer Komponenten in einer breiten Palette von Endverbrauchergeräten, darunter Elektronik, mobile Kommunikation, Computer, Automobilindustrie, Industrie und LED (Displays). Engste Zusammenarbeit von ASMPT mit seinen Kunden und kontinuierliche Investitionen des Unternehmens in Forschung und Entwicklung tragen erheblich dazu bei, dass ASMPT innovative und kosteneffiziente Lösungen und Systeme anbietet, mit denen Anwender höhere Produktivität, höhere Zuverlässigkeit und verbesserte Qualität erzielen.

ASMPT ist an der Börse von Hongkong notiert (HKEX Aktiencode: 0522) und gehört zu den Werten des Hang Seng Composite MidCap Index, des Hang Seng Composite Information Technology Industry Index, des Hang Seng Corporate Sustainability Benchmark Index sowie des Hang Seng HK 35 Index.

**Mehr Informationen zu ASMPT finden Sie auf asmpt.com.**

**Pressekontakte:**

Global ASMPT Press Office  
ASMPT Ltd.   
Susanne Oswald  
Rupert-Mayer-Straße 48  
81379 München  
Deutschland  
Tel: +49 89 20800-26439  
E-Mail: [susanne.oswald@asmpt.com](mailto:susanne.oswald@asmpt.com)  
Website: asmpt.com

HighTech communications GmbH  
Barbara Ostermeier  
Brunhamstraße 21  
81249 München  
Deutschland  
Tel.: +49-89 500778-10  
E-Mail: b.ostermeier@htcm.de  
Website: www.htcm.de